**证券代码：688047 证券简称：龙芯中科**

**龙芯中科技术股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  √现场参观 □其他 |
| 参与单位名称 | 东兴证券、海通证券、华福证券、黄河财险、上海石丸梨花私募、新沃基金、兴合基金 |
| 时间 | 2024年12月12日 |
| 地点 | 北京市海淀区中关村环保科技示范园龙芯产业园2号楼 |
| 上市公司接待人员 | 证券事务代表-李琳 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1、我们的IP核能对外授权吗？**  龙芯有自主研发的优势，拥有自主指令架构和自主IP，可以开展对外技术授权。龙芯开展IP授权业务主要是为了做生态的需要。在2023年11月龙芯3A6000的发布会上，多家企业与龙芯签署合作协议，使用基于龙架构的IP核设计芯片。目前已经有两家企业推出龙架构的芯片在售，有三所高校推出龙架构芯片。  IP授权业务的营收是按领域计入工控或信息化芯片营收的，目前体量还比较小，业务的规模化发展还尚需一定时间。理想的状态是未来有更多的企业，推出龙架构芯片，生态逐步发展起来。  **2、龙芯近期新产品的研发进展？**  桌面CPU，龙芯目前展开的下一代桌面芯片3B6600的研制，8核桌面CPU，集成GPGPU及PCIE接口。与前款芯片相比，工艺不变，结构优化。3B6600目前处于设计阶段，预计明年上半年交付流片。  服务器CPU，公司下一代服务器芯片3C6000目前处于样片阶段，预计2025年Q2完成产品化并正式发布。根据我们内部自测的结果，16核32线程的3C6000/S性能可对标至强4314，双硅片封装的32核64线程的3D6000（3C6000/D）可对标至强6338，四硅片封装60/64核120/128线程的3E6000（3C6000/Q）已在今年11月份封装回来，在测试过程中。  GPGPU芯片，目前在研的首款GPGPU芯片9A1000定位为入门级显卡以及终端的AI推理加速（32TOP），显卡性能对标AMD RX550，预计2024年底代码冻结，争取明年上半年流片。  **3、龙芯产品性价比优势怎么理解？**  2022年-2024年三年研发转型，我们的重点关注提升产品性价比和软件生态。龙芯以“三剑客”和“三尖兵”为代表的第四代产品具有很高的性价比，比如“三剑客”3A6000是面向桌面市场的芯片，相较于3A5000硅面积减小了20%，单核性能提高60%，多核性能提高100%，今年以来已得到市场检验；3C6000是面向服务器市场的芯片，与3C5000相比性能提升一倍，成本减半，处于样片阶段；定位终端的2K3000，8核终端SoC，核数翻倍，成本减半，已交付流片。  龙芯坚持自主研发，拥有自主指令架构LA，关键核心IP也都是自研，不涉及授权费用，长期看是有成本优势以及技术快速迭代优势的。再加上龙芯自主研发的GPU、桥片、电源、时钟等配套芯片，系统成本优势将更加凸显。龙芯正在将自主研发的优势转化为性价比的优势，而且我们认为性价比还有持续提升的空间。 |